

ひとわざ(一技)名: φ500 大口径セラミックスの凹面研削 公差3μm

1. 概要(200字目安)

当社は、半導体製造装置の大口径化(φ450クラス)を見据え、ロータリ研削加工の技術と、最大φ500mmのワークを測定できる平面度・平行度測定装置を開発・導入しました。

初期の試作開発に向けに形状の作り込みが容易で、多品種少量に幅広く対応したシステムです。

◆ φ500大口径セラミックス研削技術

- ・ 大口径セラミックス(最大φ500mm)を、寸法公差±3μmで研削します。
- ・ 凹面研削、平面研削が可能です。
- ・ 当社が所有するロータリ研削盤の加工技術を、最大φ500mmの測定ができる平面度・平行度測定装置で検証済みです。凹面形状をトライ&エラーで作り込むことができます。

写真・図(要点説明)

凹面形状の作り込みが可能なロータリ研削盤



最大φ500mmが測定可能な平面度・平行度測定装置

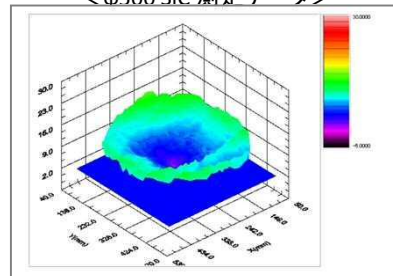


測定物: φ500SiC 平面研削加工 12μm凹面仕上げ

<研削仕上げによる表面状態(実績値)>

- ・ SiC : Ra ≤ 0.03
- ・ SiO₂ : Ra ≤ 0.05
- ・ Si : Ra ≤ 0.05
- ・ LTCC : Ra ≤ 0.08

<φ500 SiC 測定データ>



2. 企業概況

会社名	サンリツテクノ株式会社		代表者名	小島 武次			
			窓口担当	石井 昌典			
事業内容	受託加工		URL	http://www.@sanrutsutechno.co.jp			
主要製品	セラミックス・ガラス・結晶材料の精密微細加工						
住所	〒460-0045 山梨県笛吹市石和町井戸211-4						
電話/FAX	055-263-7632 / 055-263-7527		E-mail	info@sanrutsutechno.co.jp			
資本金(百万円)	15	設立年月日	昭和45年7月	売上(百万円)	200	従業員数	18

特記事項(①特許取得・各種認証等取得状況②提供できる価値及び応用分野③医療分野参入(取引)実績 他

切断・研削・研磨・穴あけ等の精密機械加工を得意とし、チャレンジ的な加工にも積極的に取り組んでいます。

チャンピオン1個の製作から、製品の作り込み、開発から量産化までをサポートします。